

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2025-055

上海新阳半导体材料股份有限公司 2025 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☐适用 ☒不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	上海新阳	股票代码	300236
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨靖	张培培	
电话	021-57850066	021-57850066	
办公地址	上海市松江区思贤路 3600 号	上海市松江区思贤路 3600 号	
电子信箱	info@sinyang.com.cn	info@sinyang.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	896,649,671.91	660,897,505.06	35.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	133,305,329.34	58,904,090.14	126.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	127,033,676.15	80,365,638.74	58.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	112,793,253.82	33,074,091.65	241.03%

基本每股收益（元/股）	0.4280	0.1895	125.86%
稀释每股收益（元/股）	0.4280	0.1895	125.86%
加权平均净资产收益率	2.97%	1.46%	1.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,106,746,216.50	5,860,673,166.39	4.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,620,250,822.06	4,536,694,935.49	1.84%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,837		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王福祥	境内自然人	14.37%	45,032,070	33,774,052	质押	12,000,000
上海新晖资产管理 有限公司	境内非国有法人	12.10%	37,933,276	0	不适用	0
上海新科投资有限 公司	境内非国有法人	7.27%	22,788,086	0	质押	6,070,000
孙慧明	境内自然人	3.51%	11,008,999	0	不适用	0
SIN YANG INDUSTRI ES & TRADING PTE LTD	境外法人	2.30%	7,216,290	0	不适用	0
金叶飞	境内自然人	2.01%	6,284,561	0	不适用	0
杨燕灵	境内自然人	1.29%	4,053,600	0	不适用	0
香港中央 结算有限 公司	境外法人	1.09%	3,403,492	0	不适用	0
金叶玲	境内自然人	0.96%	2,993,090	0	不适用	0
国泰君安 证券股份 有限公司—国联安 中证全指 半导体产 品与设备 交易型开 放式指数 证券投资	境内非国有法人	0.74%	2,326,671	0	不适用	0

基金					
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王福祥、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司为关联股东，属于一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上海新晖通过普通证券账户持有 31433276 股，通过信用交易担保证券账户持有 6500000 股，实际合计持有 37933276 股。孙慧明通过普通证券账户持有 1039000 股，通过信用交易担保证券账户持有 9969999 股，实际合计持有 11008999 股。金叶飞通过普通证券账户持有 1866245 股，通过信用交易担保证券账户持有 4418316 股，实际合计持有 6284561 股。杨燕灵通过普通证券账户持有 53700 股，通过信用交易担保证券账户持有 3999900 股，实际合计持有 4053600 股。金叶玲通过普通证券账户持有 14600 股，通过信用交易担保证券账户持有 2978490 股，实际合计持有 2993090 股。				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

公司是否具有表决权差异安排

☐是 ☒否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

报告期内，公司实现营业收入 8.97 亿元，较去年同期增长 35.67%。实现归属于上市公司股东的净利润 1.33 亿元，同比增长 126.31%，扣除非经常性损益后净利润为 1.27 亿元，同比增长 58.07%。公司半导体行业实现营业收入 7.09 亿元，同比增长 53.12%，公司半导体业务板块的新产品技术优势逐步显现，产品类型亦日益丰富。重点项目的市场开发进展顺利，客户订单数量持续攀升。报告期内，公司集成电路制造用关键工艺材料的销量

实现了显著增长，晶圆制造用电镀液及添加剂系列产品的市场份额持续扩张，集成电路制造用清洗、蚀刻系列产品在客户端的应用进展顺利，销售额持续攀升。涂料板块业务，受建筑行业市场复苏缓慢，涂料产品售价下降等不利因素影响，2025 年半年度实现营业收入 1.87 亿元，较去年同期下降 5.29%。

1、坚守创新之路，优势日益彰显

报告期内，面对产业快速发展及下游客户的迭代需求，公司围绕电子电镀、电子清洗、电子光刻、电子研磨、电子蚀刻五大核心业务技术，持续加大研发投入，创新产品技术，为客户提供整体化解决方案。报告期内公司研发投入总额 1.2 亿元，占本期营业收入的比重为 13.38%，主要集中于集成电路制造用光刻胶、先进制程湿法蚀刻液、清洗液、添加剂、化学机械研磨液等项目。

公司作为集成电路制造用关键工艺材料研发型企业，致力于加速关键工艺材料领域的技术创新及产品突破。在集成电路制造及先进封装材料领域，公司开发的用于芯片铜互连的电镀系列产品——大马士革工艺材料、硅通孔工艺（TSV）等材料被广泛应用。经过多年的技术开发，公司集成电路制造用铜互连电镀材料，已经实现高效、均匀及结晶良好的电镀效果，并持续进行技术迭代中。报告期内公司电镀液及其添加剂相关产品的销售规模持续快速攀升。

在集成电路制造用清洗及蚀刻技术方面，公司干法蚀刻后清洗液产品已经实现 14nm 及以上技术节点全覆盖，产品销售规模不断扩大，广泛应用于逻辑电路、模拟电路、存储器件等集成电路制造客户。报告期内公司开发的先进制程干法刻蚀清洗液多款新产品取得突破性进展，研发及验证工作正顺利推进，进一步扩展公司清洗液产品的应用市场，凭借卓

越的技术优势与优质的市场服务体系，公司集成电路制造用铜/铝制程清洗系列产品地位持续巩固。公司原创开发的用于芯片制造的蚀刻液产品，目前已有三代技术产品实现规模化市场销售，报告期内蚀刻液市场应用规模进一步扩大，技术及服务优势日益凸显，品牌影响力也随之不断提升。

在集成电路制造用高端光刻胶开发方面，公司依托自身的技术实力和持续的研发投入，已建成包括 I 线、KrF、ArF 干法、ArF 浸没式各类光刻胶在内的完整的研发合成、配制生产、质量管控、分析测试平台，为国内芯片企业提供多品类光刻胶产品，部分品类已实现产业化，少数品类关键光学数据处行业领先水平，公司已成为国内光刻胶供应链中重要一环。报告期内，公司光刻胶产品整体销售规模持续增加。

在集成电路制造用化学机械研磨液技术与产品开发方面，公司成熟的 STI slurry、Poly slurry、W slurry 等系列产品在客户端测试验证已完成，可覆盖 14nm 及以上技术节点，并进入批量化生产阶段，客户数量不断增加，销售额快速增长。

公司始终秉持自主创新的理念，高度重视研发技术的积累与市场开拓能力的提升。围绕公司五大核心技术持续创新，通过与产业链上下游紧密协同，不断攻克被“卡脖子”关键工艺材料产品技术难关，已成功实现从“集成电路关键工艺材料行业的跟跑者”向“局部领域的领跑者”的蜕变，公司在集成电路制造用关键工艺材料领域的综合竞争力日益增强。

2、半导体业务持续扩张，助力国产力量强势崛起

半导体行业的发展对科技和经济发展具有重要意义。随着整个半导体产业的持续增长以及中国大陆新建代工产能的不断增加，中国大陆半导体市场规模增速将会持续增加，叠

加我国国产替代大潮，国内半导体材料市场必将迎来充满机遇的蓬勃发展期。面对行业需求的快速扩大，公司制定了未来三年发展战略规划，持续聚焦“业务规模做大、技术能力做强、行业地位做高，成为半导体材料行业引领者”的发展战略。报告期内，公司布局建设的集成电路制造用关键工艺材料产品仍然面临旺盛的市场需求，尤其是集成电路制造用关键工艺材料产品销量不断攀升。

为了进一步巩固公司在国内半导体材料行业的领先地位，公司结合市场需求变化情况及整体发展规划，通过调整合肥新阳产线布局，对项目原有规划产能进行优化，产能扩充至 4.35 万吨，并追加投资至 10.49 亿元。同时，稳步推进上海化学工业区项目建设。此外，为进一步扩大产品产能，公司计划在现有厂区旁，投资建设年产 50000 吨集成电路关键工艺材料及总部、研发中心项目，预计投资总额人民币 18.5 亿元。随着公司在半导体业务产能方面布局的持续加深，新产能的陆续建成投产，公司产能规模的不断释放，能够满足未来市场需求的增长，助推公司未来发展战略规划的逐步实现。

3、全面细化管理体系，深植半导体气息

2025 年半年度公司继续推进“半导体气息”管理的落地，不断提高公司核心竞争力，提升公司风险应对能力。公司高度注重提升企业运营管理能力，不断优化完善管理体系，提升市场规划、供应链管理、质量管理、组织能力等方面运行水平。同时，逐步加强信息安全管控、建设常态化管控信息系统等工作，组建培养高质量人才队伍，满足未来集团战略管理需要，支持集团可持续、高质量发展。

随着业务规模的不断扩大，技术开发难度的不断提升，公司高度重视人才储备和团队专业能力培养和提升工作。公司结合行业需求及发展规划，组建高素质的核心管理团队和

专业化的核心技术团队，开展行业动态讲座，强化师徒带教的人才培养模式，建立员工管理、专业岗位晋升双通道，为员工搭建职业发展、学习成长的平台，完善公司各层级人才梯队建设工作，让员工与公司共同成长，持续进步。

在员工生活方面，公司通过持续开展“心温暖”民主对话会活动倾听员工心声；通过开展“人人讲安全、个个会应急—查找身边安全隐患”为主题的安全生产月系列活动，通过安全知识竞赛、全厂区隐患排查、安全知识推送等方式提升全员安全意识，落实半导体气息；通过组织“锚定三年策，奋斗新征程”团建及“上下同欲，再攀高峰”等主题活动，关注员工生活、倾听员工心声、激发员工工作和生活热情，提高员工企业文化认同感。

2025 年上半年公司持续实施股权激励计划，践行薪酬证券化长效激励机制，实施了新成长（三期）股权激励计划及 2025 年股票增值权激励计划，持续与员工共享公司发展红利，提升员工在企幸福指数。未来公司还会持续推行薪酬证券化的长效激励机制，不断吸引、聚集优秀人才，为公司未来长期稳定的可持续发展提供强有力的人才保障。

通过各项“深化半导体气息”工作的不断开展，目标是增强公司的生存成长能力和行业影响力，提升每一位员工的个人品格魅力和职业素养，最终实现企业竞争力的全面提升。

4、积极参与产业投资，助力产业蓬勃发展

长期以来，公司专注于集成电路关键工艺材料领域的深耕细作，精心策划投资布局，致力于推动集成电路全产业链中设备制造及核心原材料供应企业的成长壮大，为整个产业链的升级与繁荣贡献力量。报告期内，公司参与了由中芯聚源私募基金管理（上海）有限公司发起设立的股权投资基金——聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙），助力国家集成电路产业链的快速发展。

公司在不断精炼和完善集成电路产业链布局的过程中，积极为产业链上的尖端技术、卓越产品和优秀团队注入活力，旨在与公司主营业务产生强大的协同作用，拓展并增强产品的市场竞争力，进而巩固和提升公司在行业内的地位与影响力。

上海新阳半导体材料股份有限公司

2025 年 8 月 26 日